

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 7 部門第 2 区分
【発行日】 平成 17 年 10 月 6 日 (2005.10.6)

【公開番号】 特開 2005-72626 (P2005-72626A)
【公開日】 平成 17 年 3 月 17 日 (2005.3.17)
【年通号数】 公開・登録公報 2005-011
【出願番号】 特願 2004-356819 (P2004-356819)
【国際特許分類第 7 版】

H O 1 L 21/60

H O 1 L 23/12

【F I】

H O 1 L 21/60 3 1 1 R

H O 1 L 23/12 5 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】 平成 17 年 8 月 5 日 (2005.8.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

テープキャリアに複数の半導体素子を取り付ける (a) 工程と、
前記テープキャリアを切断する (b) 工程と、
前記 (b) 工程で前記テープキャリアから切断されてなる矩形基板に複数の外部端子を設ける (c) 工程と、
を含み、
前記 (a) 及び (b) 工程をそれぞれリール・トゥ・リール搬送の方式で行う半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載の半導体装置の製造方法において、
前記 (b) 工程で、複数行複数列で並んだ前記半導体素子を含む領域ごとに前記テープキャリアを切断する半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

請求項 2 記載の半導体装置の製造方法において、
前記 (c) 工程の後に、前記テープキャリアから切断されてなる前記矩形基板を、1 つの前記半導体素子ごとにさらに切断する半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 から請求項 3 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
前記 (a) 工程で、前記半導体素子を、前記テープキャリアに、フェースダウンボンディングする半導体装置の製造方法。

【請求項 5】

請求項 4 記載の半導体装置の製造方法において、
前記 (a) 工程で、異方性導電膜によって、前記半導体素子の電極と前記テープキャリアに形成されたボンディング部とを電気的に接続する半導体装置の製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 から請求項 3 のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
前記 (a) 工程で、前記半導体素子を、前記テープキャリアに、フェースアップボンデ

ィングする半導体装置の製造方法。

【請求項 7】

請求項 6 記載の半導体装置の製造方法において、

前記 (a) 工程で、ワイヤーボンディングによって、前記半導体素子の電極と前記テーブルキャリアに形成されたボンディング部とを電氣的に接続する半導体装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置の製造方法